

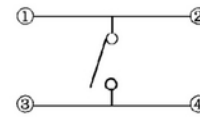
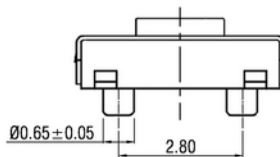
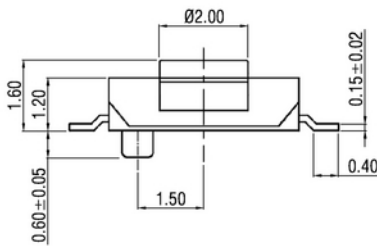
Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast/Stahl/Thermoplast, UL-94 HB
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic/Steel/Thermoplastic, UL-94 HB
Kontaktmaterial	Messing
Contact Material	Brass
Kontaktbelastbarkeit	50mA, 12V _{DC}
Contact Rating	50mA, 12V _{DC}
Kontaktoberfläche	Versilbert
Contact Surface	Silver plated
Oberfläche Lötanschluss	Versilbert
Plating Solder Side	Silver plated
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 100mΩ im Auslieferungszustand
Contact Resistance	< 100mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100MΩ im Auslieferungszustand
Insulation Resistance	> 100MΩ at initial state
Spannungsfestigkeit	250V _{AC}
Test Voltage	250V _{AC}
Temperaturbereich	-20°C ... +70°C
Temperature Range	-20°C ... +70°C
Mechanische Lebensdauer	min. 100 000 Schaltungen/Schalter (160g)
Mechanical Life	min. 50 000 Schaltungen/Schalter (250g)
	min. 100 000 operations (160g)
	min. 50 000 operations (250g)
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

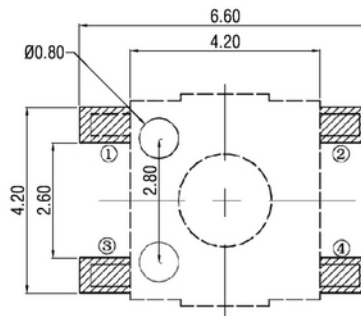
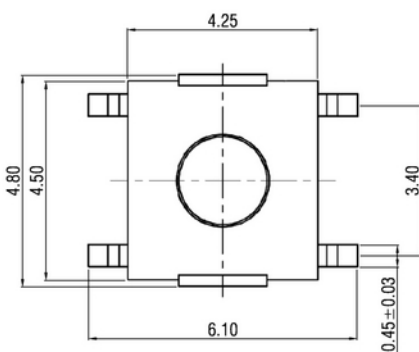


© W+P PRODUCTS

Das Foto zeigt diese Serien:
The photo shows these series:
514 515 516 517



Circuit Diagram



Recommended PCB Layout

Series	Height	Force*	Locating Pegs*	Packaging*
514	1 1 H=1.60mm	30 30 160g±30 40 250g±50	00 00 Ohne Pos.hilfe W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	TR 00 TR

Lieferformen / Packaging Options:

00 Schüttgut / Bulk goods
TR Tape & Reel / Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Löttempfhlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature T_L	230°C
Duration above T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature T_P	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 4.5min